

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

沪士电子股份有限公司
投资者活动记录表

编号：2025-0618-014

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☒ 其他： <u>网络会议</u>
活动参与人员	东吴证券、汇百川基金管理有限公司、中信保诚资管、嘉实基金管理有限公司、中信建投资管、新华基金、京管泰富、英大基金、西部证券、安联保险资产管理有限公司、长华化学、复胜资产、中邮人寿、华夏未来资本管理有限公司、大家资产、磐泽资产、圆方资本、宏利基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、盘京投资、中信建投、泰康基金、中信证券资管、润晖投资、方正富邦、天风资管、海富通基金管理有限公司、明世伙伴基金、泰康资产管理有限公司、光大永明、广发证券、中庚基金 （本次会议采取网络会议形式，参会者均未签署书面调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。下文会议纪要中的内容不代表公司对未来的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。）
时间	2025 年 6 月 18 日 11:00-12:00； 14:45-15:20
地点	公司会议室
形式	网络会议
公司接待 人员姓名	钱元君、王术梅
投资者关系活动 主要内容介绍	1、公司整体经营策略 公司差异化经营，将技术能力、制程能力、产能结构动态适配市场中长期的需求结构，坚持面向整体市场的主要头部客户群体开展业务。我们定期报告中披露的前五大客户，在 2024 年收入同比实现不错成长的同时，公司还是努力保持行业头部客户的均衡，公司向来注重中长期的可持续利益，而非仅仅局

	限于眼前的短期利益。公司深知只有着眼长远，保持客户均衡，才能在不断变化的市场环境中稳健发展，实现可持续增长。 面向整体市场的主要头部客户群体开展业务，对公司的综合竞争力提出了更高要求，这意味着公司不仅要配备完善的工具包，还要持续打磨综合制程能力与技术能力。公司需要准确把握未来的产品与技术方向，在超高密度集成、超高速信号传输等方面持续加大技术和创新方面的资源投入，通过技术创新、均衡的多元化客户结构、供应链韧性及区域布局，在复杂的市场环境中保持韧性和竞争优势，在不确定中锚定确定性。 2、公司收入结构 2024 年应用于 AI 驱动的服务器、数据存储和高速网络基础设施等领域的企业通讯市场板实现营业收入约 100.93 亿元，其中 AI 服务器和 HPC 相关 PCB 产品约占 29.48%；高速网络的交换机及其配套路由相关 PCB 产品约占 38.56%；其余主要是通用服务器、无线基础设施这些。2024 年公司汽车板整体实现营业收入约 24.08 亿元，其中公司毫米波雷达、采用 HDI 的自动驾驶辅助以及智能座舱域控制器、埋陶瓷、厚铜、P²Pack 等新兴汽车板产品约占 37.68%。 3、800G 交换机市场情况 AI 的快速发展驱动数据中心交换机市场的深刻变革。传统上，数据中心交换机支出主要用于连接通用服务器的前端网络，然而人工智能与高性能计算集群的连接需要一个数据中心规模的架构，即人工智能后端网络，同时前端网络也需要额外的容量来支持后端部署，目前来看 800G 交换机市场需求还是不错的。 4、泰国工厂 泰国生产基地目前已小规模量产。公司正在全员攻坚，以期尽快提升生产效率和稳定生产良率。公司已全面加速开启客户认证与产品导入工作，在逐步释放产能的同时，进一步验证中高端产品的生产能力，为逐步提高产品梯次打好基础，为未来的市场竞争做好准备。同时借助精细化成本管控手段，以有效控制初期成本；搭建全方位风险预警与应对机制以应对海外工厂建设运营风险，夯稳实现经营性盈利目标的桩基。
--	--

	5、资本开支及市场情况 AI 驱动的服务器、数据存储和高速网络基础设施需求增长以及新兴应用领域的拓展为行业带来发展机遇，市场上相关高阶产品的产能供应并不充裕，公司近两年已加大对关键制程和瓶颈制程的投资力度，预计 2025 年下半年产能将得到有效改善。公司近两年加快资本开支，现金流量也有相应的体现。2025 年第一季度财报现金流量表中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约 6.58 亿。除了连续实施技改扩容外，公司在 2024 年 Q4 规划投资约为 43 亿新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目预计也将于近期启动建设，预期该项目的实施能进一步扩大公司的高端产品产能，并更好的配合满足客户对高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。 从中长期看，人工智能和网络基础设施的发展需要更复杂、更高性能的 PCB 产品，以支持其复杂的计算和数据处理需求，为 PCB 市场带来新的增长机遇，同时也对 PCB 企业的技术能力和创新能力提出了更高的挑战。更多的同行也纷纷将资源向该领域倾斜，试图进入该领域并取得一定的市场份额，未来的竞争势必会加剧。公司需要准确把握战略节奏，适度加快投资的步伐，通过深入分析市场趋势和自身发展需求，合理配置资源，将更多的资金投入到具有潜力和创新的领域，不断进行技术升级和创新，开发更高密度的互连技术、更高速的传输性能等，提高产品的竞争力，并快速响应市场需求，从而抢占市场先机，筑牢并拓展“根据地”业务，实现可持续发展。 在汽车电子领域，汽车 PCB 市场处在中低端供给过剩、价格竞争、原材料价格波动、技术研发压力等复杂的环境中，呈现出规模增长、竞争加剧、需求结构变化、技术创新加速等特征，智能化成为市场重要趋势，公司首要还是致力于逐步调整优化产品和产能结构。此外公司通过和产业链合作伙伴的深度合作，持续推进应用于 800V 高压架构的产品技术优化和转移，推动采用 P²Pack 技术的产品在纯电动汽车驱动系统等方面的商业化应用。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单	无